

【美商德州儀器 Texas Instruments - 2024 暑期實習計畫】

想透過實習機會探索職涯發展可能並累積實戰經驗？對半導體產業有興趣卻不知道從何開始？期望能夠實習轉正，畢業即就業？那你千萬不能錯過 TI 今年的實習機會！

重點特色:

- ◎參與部門實際運作參與部門日常實務運作，深入了解公司營運內容，並應用所學，落實學以致用。
- ◎每位實習生皆於部門內配有一位 buddy 指導學習，協助了解文化及工作內容。
- ◎重要任務/專案指派結合工作內容，進行重要任務/專案指派，並於實習結束進行成果發表。
- ◎完整訓練與學習機會透過學長姐分享、跨部門主管論壇及課堂訓練，使實習生充分學習。
- ◎有機會得到正職預聘 offer!

強打暑期實習職缺：

★ **封裝工程師(Packaging Engineer)**:與 TI 的內部業務部門合作，一同設計與開發創新的半導體封裝技術，並專注在競爭激烈的汽車與工業半導體產業中持續推動半導體體積精簡和整合。

★ **製造部課長(Manufacturing Supervisor)**：了解工廠運作流程，帶領產線人員並與各個不同部門協作，妥善管理人/機/料/法/環，持續進行優化專案達到產能最大化!

★ **產品測試工程師(Product Test Engineer)**：同時運用硬體與軟體的知識，了解半導體製造生產流程、進行 IC 測試流程改善。

招募領域：電機電子、機械、機電、化學、材料、化工、光電、物理、醫工、應力、工業工程等科系

【徵求條件】2024 暑期大四升碩一、碩一以上同學(2025 畢業者為佳)

【工作時間】2024 年 7~8 月全職實習

★ 另有廠務、品保、製程工程師等暑期實習及正職/預聘職缺，詳細內容請至 TI 104 頁面：

<https://www.104.com.tw/company/fcgywxs>